

证券代码：301321

证券简称：翰博高新

翰博高新材料(合肥)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

| | |
|----------------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2025 年度网上业绩说明会的全体投资者 |
| 时间 | 2026 年 5 月 19 日 15:00-17:00 |
| 地点 | 深圳证券交易所“互动易平台”（ http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理 王照忠 独立董事 施海娜 财务负责人 朱 静 董事会秘书 潘大圣 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p style="text-align: center;">1、请问公司 2025 年经营情况如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注和支持！2025 年行业市场环境逐步回暖，公司把握市场发展机遇，稳步推进各项经营规划，整体经营运行态势向好，经营发展基本面持续向好。公司全年实现营业收入 32.77 亿元，同比大幅增长 39.64%，创下近年营收规模新高。公司相较上一年度实现大幅减亏，归母净利润亏损规模得到有效缩减，归母净利润</p> |

-9,679.60 万元，同比减亏 54.94%，主营业务盈利水平正持续向好回升，同时公司经营性现金流净额 2.88 亿元，健康的现金流状况充分保障了公司日常生产运营、订单承接及项目建设等各类经营活动有序开展，为企业稳定经营筑牢资金根基。在产能布局与全球化发展层面，公司海外战略布局顺利落地见效，越南两大生产基地顺利完成客户资质与产品认证工作，跨境一体化生产体系初步成型，依托海外生产基地贴近海外市场需求，有效提升海外订单交付能力，进一步拓宽海外市场发展空间。公司持续深耕背光显示模组及智能座舱显示配套相关产业，在稳固核心主业发展的基础之上，公司积极挖掘新兴产业发展机遇，布局半导体领域湿电子材料业务，多元新兴业务有序推进落地，为公司后续长远发展培育全新业绩增长动能。谢谢！

2、公司目前的核心技术优势是什么？是否具有可持续性？

答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注和支持！公司以研发驱动，拥有丰富的专利储备，已构建起覆盖消费电子、车载及前瞻性技术的系统化研发矩阵，多条技术路线迭代路径清晰，持续强化核心技术，从而在快速迭代的显示领域长期保持领先地位。公司是国内少数同时具备背光模组设计、光学开发、精密结构件加工、光学材料及 LCM 模组制造能力的厂商，公司的核心技术优势集中体现在从基础材料到系统集成的全链条自主能力上。公司不仅掌握导光板的光学模拟、光学设计及微结构转印工艺等核心技术并拥有完整知识产权，还在消费电子领域实现了高亮与热贴附技术的稳定量产；新一代超亮背光技术取得关键突破，成功开发的超亮超薄背光模组已获得多家全球知名终端品牌的设计认可；配套光学膜也已实现自主生产并具备外销能力，高色域技术达到行业领先水平；同时公司具备 Mini—LED 灯板自制能力，COB 封装产线升级后生产良

率与效率进一步提升，可全方位满足高端消费电子对显示性能的多元化需求，为公司巩固市场份额、拓展高附加值业务提供有力支撑。谢谢！

3、越南工厂 2025 年运营情况如何？未来规划是什么？

答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注和支持！为深化全球化布局发展，公司目前通过启动越南“双基地战略”——北江背光显示模组基地和胡志明精密结构件基地，构建覆盖东南亚的垂直产业链体系。北江基地聚焦背光源及液晶模组的智能化生产，为全球头部面板制造商及系统集成商提供高精度配套产品；胡志明基地专注精密冲压、注塑结构件，服务于笔记本、车载及工业显示屏等领域。公司构建覆盖东南亚的垂直产业链体系，强化国际客户需求的快速响应能力，为全球头部面板制造商及系统集成商提供高品质的产品。双基地将与国内产业园联动形成跨境产业链闭环，服务全球客户，推动公司全球化战略布局。公司先后设立了翰维科技（越南）有限公司和峰诺材料（越南）有限公司两家子公司，形成了从精密结构件到背光模组的本地化制造能力。未来，公司将持续推进越南双基地建设，加快产能爬坡进度，逐步提升海外市场份额。谢谢！

4、公司 2025 年底参与设立合资公司芯东进，并通过该平台收购韩国东进在华相关资产，请说明截至目前本次收购事项整体推进进度。

答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注和支持！公司于 2025 年 12 月参股设立合肥芯东进新材料科技有限公司（以下简称“芯东进”），注册资本 4.4 亿元，其中公司持股 45%。芯东进作为收购韩国东进在华资产的主体平台，拟以 1.421 亿美元收购韩国东进及其全资子公司香港东进共同设立的特殊目的公司 70%股权，标的核心资产包含韩国东进境内 9

| | |
|----------|---|
| | <p>家目标公司 100%股权及 24 项相关专利。截至目前，东进世美肯（上海）新材料有限公司已设立并拟作为项目公司归集持有本次收购的资产，芯东进收购韩国东进在华湿电子化学品资产正按收购协议约定有序推进相关交割事项。谢谢！</p> <p>5、贵公司未来发展怎么考虑的？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好，感谢对翰博高新的关注和支持！公司未来将紧密围绕半导体显示主营业务，在治理层面，将从内部生产优化与外部供应链两方面发力，加速新基地产能利用率爬坡，建设垂直一体化体系，依托越南双基地推动全球化布局，持续提升运营效率与成本管控能力。在研发创新与人才建设层面，将进一步加大投入，打通技术研发到产业应用，同时完善人才梯队培养体系，优化薪酬激励与绩效管理，打造高素质核心团队，为未来发展提供坚实的组织保障。在业务层面，公司将持续聚焦半导体显示技术升级与迭代，重点包括超亮超薄背光模组、持续优化防窥导光板、车载量子点 LED 技术，以及碳纤维背板方案，强化产品上的差异化优势，提升模组制造的数智化升级。同时，公司加速布局车载连屏、异形屏等创新形态，提升产品在中高端车型的渗透率与业务市场份额，深化和 Tier1 供应商、车厂的合作。依托参股公司布局湿电子材料赛道，未来将构建从半导体显示到半导体材料的产品体系，为公司中长期发展打造新的增长引擎。谢谢！</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2026 年 5 月 19 日 |